证券代码：688630　　证券简称：芯碁微装　　公告编号：2026-050

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **增资标的名称：**合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 CFM Global Limited（以下简称“香港子公司”）。
- **增资金额：**公司拟使用 H 股上市发行募集资金对香港子公司增资，增资金额最高不超过约 9,700 万港元（不超过约 8,250 万人民币，最终增资股本将按届时适用汇率，并结合相关 ODI 审批额度予以确定）。
- 增资后公司对香港子公司总投资金额不超过人民币 8,500 万元，最终增资股本将按届时适用汇率，并结合相关 ODI 审批额度予以确定。
- 本次增资事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、增资事项概述

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日在中华人民共和国香港特别行政区注册设立了全资子公司 CFM Global Limited（以下简称“香港子公司”），系公司持有 100% 股权的全资子公司，定位为公司面向全球市场的离岸创新与运营枢纽。目前，香港子公司已完成境外

企业注册，但未实缴注册资本、未投入资产权益及开展其他境外投资活动，尚未发生实际出资，未发生实际经营活动。

为充实香港子公司资本实力、优化其财务结构，确保其离岸创新与运营平台功能稳健运行，并抓住全球市场拓展窗口期实现跨越式发展，公司拟使用 H 股上市发行募集资金对香港子公司增资，增资金额最高不超过约 9,700 万港元。香港子公司现股东为公司一家，持有其 100% 股权，本次增资由公司单方以现金方式认购新增股份，不涉及其他股东同比例出资，亦不导致其他股东权益变动。增资完成后，香港子公司已发行股份数由 3,000,000 股增至不超过约 100,000,000 股。增资后公司对香港子公司总投资金额不超过人民 8,500 万元，最终增资股本将按届时适用汇率，并结合相关 ODI 审批额度予以确定。

公司于 2026 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用 H 股上市发行募集资金对香港子公司增资，增资金额最高不超过约 9,700 万港元（不超过约 8,250 万人民币），并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。

本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次增资事项尚需相关部门审批或备案，实际投资金额以最终获批的境外投资备案额度为准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、增资标的具体信息

（一）增资标的基本情况

项目	内容
法人 / 组织全称	CFM Global Limited
成立日期	2026 年 3 月 18 日
注册地	中华人民共和国香港特别行政区

公司类型	私人股份有限公司
注册地址	香港九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心 2 座 16 楼 1610 室
已发行股本及股本总额	3,000,000 股普通股，股本总额 3,000,000 港元
控股股东	合肥芯碁微电子装备股份有限公司，持股 100%
主营业务	境外采购与国际结算；海外市场拓展与售后服务；境外投资及投融资平台运作等。
所属行业	专用设备制造（半导体及电子专用设备）相关

（二）本次增资的要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司（√同比例　□非同比例） --增资前标的公司类型：√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	CFM Global Limited
增资金额	√已确定，具体金额（万元）：不超过约人民币 8,250 万元（约 9,700 万港元，最终增资股本将按届时适用汇率，并结合相关 ODI 审批额度予以确定。） □ 尚未确定
出资方式	√现金 □自有资金 √募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	√是　□否

（三）增资前后股权结构

单位：港元

序号	股东名称	增资前	增资后

		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	3,000,000	100	预计不超过100,000,000	100
合计		3,000,000	100	预计不超过100,000,000	100

注：增资后对香港子公司的总投资金额不超过人民币 8,500 万元，增资后股本约 100,000,000 港元，具体的增资后股本将按届时适用汇率，并结合相关 ODI 审批额度予以确定。

三、本次增资对公司的影响

本次增资主要是为保障公司离岸创新与运营枢纽建设顺利推进落地，落实招股说明书已披露的所得款项用途安排，提升香港子公司在海外销售及服务网络搭建、前沿研发引智等方面的项目承接及资金运作能力，满足募投项目实施过程中的资金需求，保障相关业务有序开展，有利于保障公司海外业务的后续建设与运营顺利实施。

本次增资完成后，不会导致香港子公司股权结构发生变化，公司仍持有其 100% 股权；不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资的资金来源为公司 H 股全球发售所得款项净额中用于扩大国际销售业务及海外销售与服务网络部份，募投项目实施主体为公司全资子公司，全资子公司仍将募集资金用于 H 股招股说明书中披露的建立及拓展集团的海外销售网络，不构成改变募集资金用途。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险提示

本次增资须履行境内 ODI 备案及外汇登记等手续，涉及股份配发还需向香港公司注册处办理配发申报。上述程序能否办妥及办理时间存在不确定性，若迟延或未能取得相关意见，可能影响本次增资实施进度。

香港子公司业务依托境内外 PCB 及半导体行业等下游产业的资本开支与设备需求，若相关产业资本开支下行、终端消费疲软或同质化竞争加剧，可能导致

海外销售及海外技术服务中心效益不及预期。国际贸易环境变化、关税调整及出口管制等不确定性，亦可能对其供应链协同、技术合作及市场拓展产生不利影响。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日